

AXEL

Xtend y MoldWiz®

Desmoldeantes para Composites



Piezas con gel coat y buen acabado brillante SEMI PERMANENTES

			Molde abierto / Laminado manual / Spray- / Infusión	RTM / Compresión	Mármol sintético / Casting Cemento polimérico	Enrollamiento	SMC / BMC	W = base agua S = -base solvente
818	Aplicar y dejar secar	Temperatura ambiente	▲	■				S
824 (bajo slip)	Aplicar y dejar secar	Temperatura ambiente	▲	■				S
830	Aplicar y lustrar	Temperatura ambiente	▲	▲				S
840	Spray o a mano	Moldes calientes hasta 65°C	■	▲	■			S
858	Spray o a mano	Ambiente o más elevada	▲	■				S
W-102	Aplicar y lustrar	Temperatura ambiente	▲	■				W

Piezas sin gel coat SEMI PERMANENTES

19ZAM	Aplicar y dejar secar	Temperatura ambiente	▲	▲	▲	▲		S
19RBU	A mano o spray	Temperatura media 65°C	■	▲				S
W-7838D (acabado mate)	A mano	Temperatura ambiente	▲	▲				W

Selladores SEMI PERMANENTES

XTR	Aplicar y lustrar	Temperatura ambiente	▲	▲	▲	▲	▲	S
WS-50 (acabado mate)	Aplicar y dejar secar	Temperatura ambiente	▲	▲	▲	▲	▲	W

Piezas con gel coat y buen acabado brillante

F-57L/NA	Aplicar, secar y pulir	Temperatura ambiente	▲					S
250-SL/55NC	Aplicar, secar y pulir	Temperatura ambiente	▲		▲			S

Piezas sin gel coat

WB-2700, WB-2700A	A mano o Spray	Ambiente hasta 235°C	▲	▲	▲	▲	▲	W
JB-5	A mano o Spray	Ambiente hasta 205°C					▲	W

Sellador

Melax® 3F/NA	Aplicar, secar y pulir	Temperatura ambiente	▲	■	■	■	■	S
--------------	------------------------	----------------------	---	---	---	---	---	---

Cera

Paste Wiz®	Aplicar y pulir	Temperatura ambiente	▲					S
------------	-----------------	----------------------	---	--	--	--	--	---

Limpiadores y decapantes

CW-9/NA	Poner y quitar; y lavar con agua	Temperatura ambiente	Limpiador y decapante. Excelente para quitar las ceras.					S
CX-500	Poner y quitar	Temperatura ambiente	Limpiador general					S
CX-525	Poner y quitar	Templado hasta 95°C	Limpiador y decapante. Recomendado para moldes cerrados o calientes.					S
CX 200HS	Poner y quitar	Temperatura ambiente	Decapante					S

▲ Recomendado ■ Apropiado

Recomendaciones basadas en el tipo de resina, peróxido o agente de curado

Poliéster

Tipo de Peróxido	Grupo	Producto	Aplicación	Otros Comentarios
BPO	Diacril Peróxidos	INT-PUL24 INT-1854 INT-54 INT-541WT		
MEKP	Cetona Peróxidos	INT-EQ6 INT-15TBT INT-937 INT-DCP220	Moldeo abierto y cerrado Gel Coats	Especial para resinas DCPD
MEKP, AAP, CHP	Cetona Peróxidos	INT-1838P	RTM, SMC baja temperatura	
2,4-Pentanedione	Cetona Peróxidos	INT-15TBT		
Perkadox 16 (Akzo)	Peroxicarbonato	INT-PS125 INT-PUL24		
Perbenzoato butílico terciario TBPB	Peroxiesters	INT-PUL24	Pultrusión	
Perkadox 16 + TriganoxC (Akzo)	Peroxicarbonate Peroxiesters	INT-PUL24 INT-PS125	Pultrusión	
Dicumil peróxido	Dialkil Peróxidos	INT-PUL24		
Cumene hydroperoxide	Hidroperoxidos	INT-1838P	RTM, SMC baja temperatura	Especialmente efectivo con vinil ester y piezas gruesas
Lupersol 231 (Atofina)	Peroxiketals	INT-PUL24 INT-EQ6	SMC	

Epoxi

Agente de curado	Producto	Aplicación	Otros Comentarios
Amina alifática ejemplo: DETA	INT-1846N2	Para moldeo a temperatura baja o moderada	Neutralizado para prevenir una reacción acelerada
Amina alifática	INT-1850HT	Procesos de alta temperatura > 175°C	Buena estabilidad térmica
Imidizol	INT-1846N2		
Amina ciclo alifática ejemplo: PACM	INT-1840	Moldeo por enrollamiento	Acidez reducida, no afecta a las propiedades de curado

Aminas aromáticas base MDA y no MDA	INT-1846	Moldeo por enrollamiento	Máximo efecto en superficie
Aminas aromáticas base fluorina	INT-1824L	Curados de alta temperatura >230C	Mínimo impacto en Tg, aunque se utilice en dos fases.
Acido anhídrido ejemplo: MTHPA	INT-1846N2	Pultrusión	
Anhídrido claro	INT-1810	Encapsulado de componentes eléctricos	Moldeo claro sin turbidez
Anhídrido, general	INT-1854		
Aminas o poliamidas dispersadas en agua	INT-EP545/SL		Excelente para emulsiones de epoxi Bueno para superficies veladas
Ácidos de Lewis ejemplo: BF3.MEA	INT-1815	Curado rápido a baja temperatura ambiente-50°C	No retrasa la polimerización
Epoxi acrilatos de curado UV	INT-1210 INT-1285C		Moldeo claro sin turbidez

Fenólica

Agente de curado	Producto	Aplicación	Otros Comentarios
Resole, base metanol	INT-PUL14	Pultrusión	
Resole, base agua 2 fases	INT-1830PN	Para BMC	
Resole, base metanol	INT-1312MS	Laminados y FRP	
Resole, base agua	INT-26LF95	Laminados y FRP	Para formulas de espuma de baja densidad
Resole, base agua, 2 fase curado acido sulfónico	INT-1848PN	Para SMC	
Novalac, en polvo y hexa-curado	INT-1838P	Moldeo por compresión	
Novalac, en polvo, hexa-curado y en suspensión en metanol	INT-1838P	Moldeo por compresión	Buen desmoldeo en prensas de cobre para artes gráficas

www.axelplastics.com

www.jamat.net